



台灣股市深度分析報告

Taiwan Stock Market Deep Analysis

July
17

2026年06月22日 週一

一、大盤概況

加權指數收盤

47,741.51

▲ 1,276.31 點 (2.75%)

台積電 (2330)

2,510.00

▲ 100.00 點 (4.15%)

二、主要權值股表現

個股	收盤價	漲跌
鴻海 2317	268.50	+0.00 (+0.00%)
聯發科 2454	4,465.00	+75.00 (+1.71%)
台達電 2308	2,150.00	+0.00 (+0.00%)
廣達 2382	380.00	+4.00 (+1.06%)
奇鋁 3017	2,420.00	+20.00 (+0.83%)
聯詠 3034	567.00	+51.00 (+9.88%)

三、國際股市收盤 (前日 / 當日)

指數	收盤價	漲跌
道瓊工業	51,564.70	+72.15 (+0.14%)
S&P 500	7,500.58	+80.48 (+1.08%)
那斯達克	26,517.93	+496.27 (+1.91%)
費城半導體	14,341.78	+864.71 (+6.42%)

四、技術面觀察

- 5日均線：46,258 點
- 20日均線 (月線)：44,897 點
- 20日高低點：47,742 / 43,149
- ✓ 指數站上 5 日均線，短線偏多
- ✓ 指數維持於月線之上，中期趨勢偏多

五、類股輪動與族群分析

 強勢族群：半導體

六、籌碼與法人動向

由於公開資料源限制，即時的三大法人（外資、投信、自營商）買賣超金額無法透過公開 API 取得。

建議參考證交所每日盤後統計的「法人進出表」，或鉅亨網相關報導以掌握最新籌碼動向。

💡 一般而言：外資動向影響大盤中線走勢最為關鍵；投信偏向短線操作；自營商則常鎖定權值股與ETF做價差。

七、市場新聞摘要

1. 精選〈台股盤後〉台指期帶路 台積電領軍創第七大漲點1276點 收47741點新高

台股今日在盤中台積電發威大漲 100 元帶動 IC 設計、封測及權值股及中、小型電子股的大力攀升同時，台股大盤以大漲 1276.31 點或 2.75% 作收，收盤報 47741.51 點收盤，成交值 1.44 兆元。...

2. 波若威：CPO產品H2量產出貨 光被動元件三大產品應用拚發光

波若威 (3163-TW) 受惠於光纖套件成功打入 AI 大廠輝達 (NVDA-US) 共同封裝光學 (CPO) 生態系，相關產品線持續邁進，包含光纖套件及光纖配線盒產品群產品，預計會在今年下半年度開始量產出貨，第 4 季逐步放量。...

3. 輝達AI霸權鬆動？小摩：ASIC將於2027年超車GPU、博通成最大贏家

摩根大通最新報告指出，Google TPU、AWS Trainium、微軟 Maia 與 Meta MTIA 等客製化 AI 晶片 (ASIC/XPU) 正快速崛起，預計 2027 年出貨量將首度超越輝達 GPU。隨著資料中心面臨電力瓶頸，「...

4. 川普警告美國恐收荷姆茲通行費！美伊談判代表抵達瑞士、以色列成最大變數

美國總統川普警告，若美伊最終無法達成協議，美國可能對荷姆茲海峽收取通行費，以補償維護中東安全的成本。與此同時，美國副總統范斯、伊朗代表及多國調解人齊聚瑞士展開關鍵會談，核問題、黎巴嫩停火及荷姆茲海峽通航權成為談判焦點，美...

5. 記憶體成「AI最緊瓶頸」！德銀警告：恐加劇整體通膨、破壞力蔓延至宏觀經濟

德意志銀行指出，AI 浪潮帶動高頻寬記憶體 (HBM) 需求暴增，正在排擠傳統 DRAM 與 NAND 產能，形成結構性記憶體短缺危機。德銀預估 DRAM 價格最高將飆升 63%，短缺恐延續至 2028 年，並推升消費電子、汽車價格與通膨壓力，...

6. 台積電CoWoS遇天花板？玻璃基板接棒、英特爾搶先量產

隨著 AI 晶片規模持續擴大，台積電 CoWoS 先進封裝面臨成本高、尺寸受限與翹曲問題等三大瓶頸。玻璃基板憑藉低成本、大尺寸、高密度互連與低訊號損耗優勢快速崛起，英特爾、台積電與三星積極布局，預計 2028 年後加速量產，成為下一...

八、投資觀察重點

- 加權指數強彈 +2.75%，多方展現強勁抵抗力道
- 台積電領漲 +4.15%，帶動電子族群與大盤信心
- 美股那斯達克大漲 +1.91%，科技股情緒同步轉佳
- 費半指數大漲 6.42%，半導體族群動向值得關注
- 指數站上 5 日均線 (46258)，短線偏多看待
- 指數維持月線 (44897) 之上，中期趨勢偏多

⚠ 免責聲明：本報告由自動化程式生成，資料來自 Yahoo Finance API、鉅亨網等公開網路來源，僅供參考，不構成投資建議。投資人應自行判斷並承擔風險。報告生成時間：15:00

 2026-06-22 台灣股市深度分析報告

自動化生成 | 每日收盤後發送